

技術部 技術講習会のお知らせ

「ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作」

技術部装置開発グループ

対象 : 工学部4年生および工学研究科大学院生、
工学研究科教職員

日時 : 講習会受付期間 2014年6月～2014年11月末。
講習会実施日 2014年6月～2014年12月中旬(随時実施)。
講習希望者と相談の上、講習日を決定します。
講習時間 3-4時間程度。

場所 : 第二合同棟 物理工学科 ナノ加工工作室(6106室)

内容 :
・ ボール盤作業とねじ切りの基礎知識についての講義。
・ 数種類(軟鋼、ステンレス、アルミ、黄銅)の金属を使用して、
ボール盤による穴あけとタップ、ダイスによるネジ切り実習を行います。
(ペーパーウエイトの製作を行います。)

受講人数 : 1回 2-4人程度を予定しています。
先着30名程度(材料の都合のため)

申込方法 : 所属研究室名、氏名、靴のサイズ(安全靴使用のため)を
記入の上、下記のアドレスへお送りください。

*なお、ご質問等、ございましたら、下記のアドレスまたは、
電話にてご連絡ください。
ほかの材料についてのボール盤実習を希望される方がありましたら、ご相談ください。

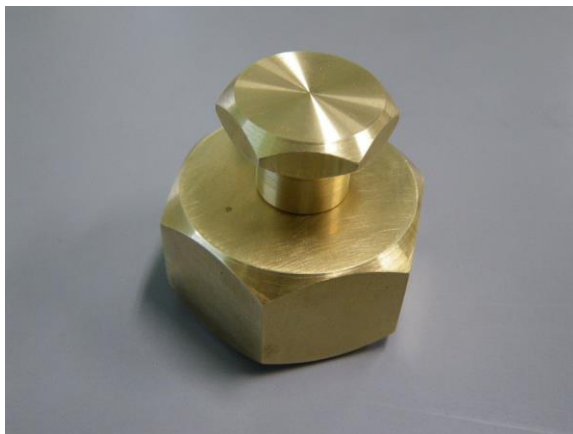
*服装は、汚れてもよい、作業に適した服を着用のこと。
(安全のため、作業に適した服装でないと判断した場合は、
お断りすることがあります。)

連絡先 技術部装置開発グループ 村井健一
murai@phen.mie-u.ac.jp 電話 内線 9377

技術部 技術講習会(2014年度)

「ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作」

技術部装置開発グループ
スタッフ 小林、堀場、村井



場所 : 第二合同棟 物理工学科 ナノ加工工作室(6106室)